

# 力積電銅鑼新廠動土 臺灣半導體產業再添一軍

New Plant of Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. at the Tongluo Science Park Groundbroke

力積電（パワーチップ）銅鑼科學園區の新工場着工式  
台湾半導体産業に新強豪

文・圖 / 投資組 翁淑婷、呂慕晞

力積電電子製造股份有限公司投資新臺幣 2,780 億元於銅鑼園區動土興建 2 座 12 吋晶圓廠。於 3 月 25 日舉行動土典禮，蔡英文總統、美國在台協會鄺英傑處長、科技部林敏聰次長及科管局王永壯局長等貴賓應邀出席，共同動鏟。蔡總統表示，臺灣不僅在半導體先進製程上領先全球，在全球供應鏈上也佔關鍵地位。從「護國神山」到「護國群山」，證明半導體產業有越來越多具有國際競爭力的廠商，從 IC 設計、晶圓代工到封裝測試，上下游一起合作，用最堅強的實力來打產業國際盃。



共同動鏟：蔡英文總統（左 6）、科技部林敏聰次長（左 3）、科管局王永壯局長（左 1）

力積電從 DRAM 製造轉型為晶圓代工，為唯一掌握邏輯與記憶體二大晶圓製造技術之知名廠商，著眼於未來記憶體、面板驅動 IC 及電源管理 IC 市場需求，銅鑼新廠預計 2023 年可開始初期量產，並持續擴充產能，一、二期廠房分別預計於 2025 年及 2030 年完工，預計 10 年後產能可達 10 萬片，產值達每年 600 億元以上，並將創造 3,000 名以上就業機會。銅鑼科學園區位於竹科與中科之間，處於臺灣半導體產業廊帶之樞紐，迄今已有 19 家廠商進駐，投資金額逾 119 億元，進駐產業包括半導體先進測試與材料、智慧機械及車用電子研製相關組件與設備商，力積電新廠量產後將提高我國半導體產業優勢，強化我國半導體先進製程中心之實力。

# 笙特科技宜蘭一期廠房開工迎春

First Phase New Fab of Sangtech Lab Inc. at Yilan Science Park Started Works

「Sangtech」宜蘭科學園區工場一期着工、春を迎える

文・圖 / 投資組 吳珮珊

笙特科技股份有限公司於 3 月 25 日上午 10 時 30 分舉行宜蘭一期廠房開工典禮，為今年宜蘭園區第一家開工動土的廠商。典禮由阮董事長親自主持，科管局胡世民主任秘書、宜蘭縣林建榮副縣長及宜蘭市江聰淵市長均到場祝賀。

笙特科技為專業的醫療器材 ODM 公司，笙特佈局未來，選定宜蘭園區設置研發基地，持續開發符合臨床需求之醫材產品。胡主任致詞表示，在科管局積極推動下，宜蘭園區已有 32 家廠商核准進駐，其中就有 12 家屬於生技產業，已然成為醫療器材產業新興聚落。目前第一期標準廠房已近滿租，科管局刻正興建第二期標準廠房，預計於今年 8 月完工，歡迎各大企業加入投資宜蘭園區的行列。



科管局胡世民主任秘書（右 2）、宜蘭市江聰淵市長（右 3）、笙特阮天助董事長（左 4），宜蘭縣林建榮副縣長（左 3）